



# Mr. Prober Technology(MPT)

## 普若博科技 台灣分公司

### EG2001X/CX 操作手冊 For 作業員及新人

#### 1. SETUP 流程說明:

1-1 安裝 PROBE CARD.

1-2 設定 PROBE TIP 中心點.

按 **PROG** ⇒ **4** ⇒ 移動 FORCER 使 CHUCKTOP 中心點對準

PROBE CARD 中心點 ⇒ **2** ⇒ **ENTER**

1-3 輸入 FLAT POSITION (平邊方向).

**SET OPTION** ⇒ **1** ⇒ **ENTER** ⇒ **1** ⇒ **ENTER**

⇒ **1** ⇒ **ENTER** ⇒ 輸入所需之角度 ⇒ **ENTER** (離開)

1-4 輸入 X/Y DIE SIZE.

**SET PRMTR** ⇒ **1** ⇒ **ENTER** ⇒ **136** ⇒ **ENTER**

⇒ **136** ⇒ **ENTER** ⇒ **ENTER**

1-5 放置 CASSETTE 及 WAFER 到 SENDER 和 RECEIVER, 按下"START"使 CASSETTE 下降.

1-6 LOAD WAFER 到 CHUCKTOP 上.

按 **LOAD**

1-7 FIND TARGET (WAFER 作水平校正)

按 **FIND TARG** ⇒ 使小方框對準 DIE 的角落,且黑白對比明顯以及不與周遭圖形類似.

竹北市新泰路 35 號 8 樓之 3 Tel: 886-3-5514005, Fax: 886-3-5514003

8F-3, No. 35 Hsi-Tai Rd. Hsi-Chu-Chupei City, R.O.C

⇒ **PAUSE/CONT.** ⇒ **ENTER** ⇒ **ENTER**



**1-8 PROFILING WAFER 及設定工作高度.**

按 **PROG** ⇒ **4** ⇒ **Z**

配合 MICROSCOPE 及上下搖動 JOYSTICK, 使 PROBE TIPS 剛好接觸 WAFER 表面.

⇒ **3** ⇒ **ENTER**

**1-9 PROBE TO PADS 及設起測 DIE 位置.**

配合 MICROSCOPE 及上下左右搖動 JOYSTICK, 使所有 PROBE TIPS 剛好對準 PADS 的中心點.  
 接者 JOYSTICK 轉到 “INDEX” 模式, 移到起測位置, 按

**FIRST**

**2. OPERATOR CONSOLE 介紹:**

按鍵	功能	內容
<b>VAC</b>	真空開關	手動切換 CHUCKTOP 的真空進出.
<b>LOAD</b>	Chuck Top 回到 Home 或 Load 位置	Wafer 傳入/傳出 Chuck top.
<b>ALIGN SCAN</b>	手動水平校正	移動 Chucktop 到 Probe tips 底下作 X 軸左右來回移動, 作 Theta 調整.



<b>INK ENBL</b>	Inker 開關	在主畫面會顯示 Inker “ENB” 或 “DIS”.
<b>LAMP</b>	燈光開關	Microscope 及 Camera 燈光開關.
<b>AUTO PROBE</b>	啓動測試	執行自動測試程序.
<b>PAUSE/ CONT</b>	暫停鍵	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 暫停 “AUTO PROBE”</li> <li>* 執行 “ALIGN SCAN”</li> <li>* 貯存影像點，以執行 AUTO ALAIGN.</li> </ul>
<b>INK TEST</b>	試打 INKER	調整 INKER 工作位置時使用 .
<b>TEST CYCLE</b>	手動測試鍵	手動啓動測試動作，主畫面將產生 PINCODE 顯示.
<b>Z</b>	移動 Chuck Top 上升下降	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 按下此，鍵主畫面將產生 “UP” 和 “DOWN”.</li> <li>· 啓動 “PROG”內的 Z 軸調整.</li> </ul>
<b>CAMR</b>	影像開關	影像畫面和文字畫面切換.

### 3. MONITOR KEYBOARD 介紹:

按鍵	功能	內容
<b>SET PRMTR</b>	SET PARAMETER 顯示畫面	所輸入的數值,當按下 “ENTER” 時即生效.



<b>SET MODE</b>	SET MODE 顯示畫面	所選擇的模式將會改變操作模式.
<b>SET OPTION</b>	SET OPTION 顯示畫面	使用數字鍵輸入數值或者開關選用配備.

按鍵	功能	內容
<b>0~9</b>	數字鍵	選擇功能列;輸入數值或動態資料.以”ENTER”鍵將資料移入暫存區或完成輸入.
<b>ENTER</b>	傳入資料或離開	選擇功能列;輸入數值或動態資料之後,按”ENTER”鍵.
<b>CE</b>	清除輸入的數字	清除數值,功能列或者參數.
<b>←</b>	清除前一數字 (或測試時作 X 軸轉向)	清除前一個輸入的數字,以便重新輸入. (測試暫停時,按下此鍵可更改 X 軸移動方向.)
<b>.</b>	小數點	提供給予數值的小數點運用.
<b>—</b>	數字負號	提供給予座標的負號.
<b>X</b>	啓動 X-Y 移動	配合 PROFILER 操作畫面使用.
<b>Y</b>	YES	有 YES/NO 選項時使用.
<b>FIRST</b>	FIRST DIE 位置 存入暫存區	設定每片 Wafer 的起測點,下一片 Wafer 進來測試將會到此相同點開始測試.
<b>LEARN</b>	顯示 LEARN 畫面 以供輸入 Die 和 Micro site 座標	輸入 Die 的 X/Y 座標值.



---

<b>STORE</b>	將 Die 內的 Micro 座標值存入暫存區	貯存 Die 內,Probe tips 所指的位置.
<b>DELETE</b>	從暫存區清除單一 Die 座標值	當<STORE>和<DELE>鍵按下時會有嗶聲出現確認動作.

<u>按鍵</u>	<u>功能</u>	<u>內容</u>
<b>FIND TARG</b>	選擇影像參考點以供比對	使用搖桿去選擇影像參考點,按下<PAUSE/CONT>鍵去做 Wafer 水平校正.
<b>AUTO ALIGN</b>	Wafer 水平校正	利用<FIND TARG>貯存之影像點做 Wafer 水平校正.之後移至起測點.
<b>DIG VID</b>	影像自動增益補償	影像明暗度及黑白對比校正.
<b>ON LINE</b>	啓用 RS232 或 GPIB 介面控制	在主畫面顯示"ON LINE" 和 "OFF LINE".
<b>PRINT</b>	啓動列表動作	印 Wafer Log 或 Casstte Log.
<b>RUN ID</b>	輸入 Lot No. Type Wafer No.	輸入 Wafer 號碼,產品型號及批號.
<b>PROG</b>	Profiler 畫面	使用 N.C.E.S.功能操作.



**DIAG**

模擬操作

模擬測試模式.

**DISK**

磁碟機系統操作

Format 及複製磁片,存取資料和系統開機.

#### 4. 開關機順序:

##### 4-1 開機:

- 4-1-1 VISION MODULE -- POWER TURN “ON”.
- 4-1-2 FLOPPY DISK DRIVER – ALWAYS “ON” 及放入開機磁碟片.
- 4-1-3 TURN “ON” PROBER CONTROL MODULE.
- 4-1-4 定位 FORCER.

##### 4-2 關機:

- 4-2-1 關 PROBER CONTROL MODULE 電源.
- 4-2-2 關 VISION MODULE 電源.